

Nuovo grado ForTii per elettronica

Alternativo a LCP e PPA, è già stato adottato da un produttore tedesco di blocchetti terminali per circuiti stampati.

2 luglio 2013 04:23

Per la produzione dei blocchetti terminali montati sui circuiti stampati con tecnologia SMT (surface mount technology), DSM ha sviluppato il nuovo grado T11, appartenente alla serie di poliammidi resistenti alle alte temperature (PA4T) Stanyl ForTii.



Il materiale, privo di alogeni, combina ritardo alla fiamma (UL94-V0), resistenza alle alte temperature e buone proprietà meccaniche; in aggiunta è conforme ai requisiti RoHS, RAEE (rifiuti elettronici) e, a detta del produttore, possiede una impronta al carbonio pi¹ favorevole rispetto a materiali alternativi quali polimeri a cristalli liquidi (LCP) e poliftalammidi (PPA).

I bocchi terminali connettono i circuiti stampati con i dispositivi esterni; sono comunemente impiegati in macchine utensili, sistemi di automazione, trasporti e costruzioni.

Stanyl ForTii T11 è stato omologato o è in fase di test presso alcuni produttori di blocchi terminali. La tedesca Weco Contact, con sede ad Hanau, l'anno scorso ha deciso di adattare questo grado per i blocchetti e i pin strip della gamma SMartConn.

© Polimerica - Riproduzione riservata